

2011-2015年中国挠性覆铜 板（FCCL）行业市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2011-2015年中国挠性覆铜板（FCCL）行业市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1101/Q77504338O.html>

【报告价格】纸介版6500元 电子版6800元 纸介+电子7000元

【出版日期】2011-01-20

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

报告说明:

博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国挠性覆铜板（FCCL）行业市场分析与投资前景研究报告》共十三章。首先介绍了挠性覆铜板（FCCL）行业相关概述、中国挠性覆铜板（FCCL）产业运行环境等，接着分析了中国挠性覆铜板（FCCL）行业的现状，然后介绍了中国挠性覆铜板（FCCL）行业竞争格局。随后，报告对中国挠性覆铜板（FCCL）行业做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国挠性覆铜板（FCCL）产业发展前景与投资预测。您若想对挠性覆铜板（FCCL）产业有个系统的了解或者想投资挠性覆铜板（FCCL）行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

第一章 挠性覆铜板的品种及主要性能要求

第一节 按不同基材分类的FCCL品种

第二节 按不同构成分类的FCCL品种

第三节 按不同应用领域分类的FCCL品种

第四节 FCCL品种的其它分类

第五节 产品主要采用的标准及性能要求

一、FCCL相关标准

二、FCCL的主要性能要求

第二章 挠性覆铜板的制造工艺法及其特点研究

第一节 三层型FCCL的制造工艺法及其特点

一、片状制造法

二、卷状制造法

第二节 二层型FCCL的制造工艺法及其特点

一、涂布法

二、溅射/电镀法

三、层压法

四、三种工艺法生产的2L-FCCL在性能、工艺特点方面的比较

第三节 近年FPC的技术发展方面

一、二层型FCCL已成品种发展的主流

二、FCCL近年在技术方面的进步

第三章 2009-2010年世界挠性覆铜板市场发展现状分析

第一节 2009-2010年世界挠性覆铜板产业发展概述

一、挠性覆铜板发展历程

二、世界FCCL市场规模及两品种的比例

三、世界挠性覆铜板市场的规模

第二节 2009-2010年世界挠性覆铜板区域市场分析

一、美国

二、日本

三、德国

四、韩国

第三节 2010-2015年世界挠性覆铜板产业发展前景预测分析

第四章 2009-2010年世界挠性覆铜板主要企业运营走势分析

第一节 新日铁化学株式会社

一、公司基本概况

二、2009-2010年公司经营与销售情况分析

三、2009-2010年公司竞争优势分析

四、公司国际化战略发展

第二节 宇部兴产株式会社

一、公司基本概况

二、2009-2010年公司经营与销售情况分析

三、2009-2010年公司竞争优势分析

四、公司国际化战略发展

第三节 台湾律胜科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、2009-2010年公司经营与销售情况分析

三、2009-2010年公司竞争优势分析

四、公司国际化战略发展

第四节 新揚科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、2009-2010年公司经营与销售情况分析

三、2009-2010年公司竞争优势分析

四、公司国际化战略发展

第五节 亚洲电材企业集团亚洲电材股份有限公司

一、公司基本概况

二、2009-2010年公司经营与销售情况分析

三、2009-2010年公司竞争优势分析

四、公司国际化战略发展

第六节 旗胜科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、2009-2010年公司经营与销售情况分析

三、2009-2010年公司竞争优势分析

四、公司国际化战略发展

第七节 东丽世韩有限公司

一、公司基本概况

二、2009-2010年公司经营与销售情况分析

三、2009-2010年公司竞争优势分析

四、公司国际化战略发展

第八节 SD 电线有限公司

一、公司基本概况

二、2009-2010年公司经营与销售情况分析

三、2009-2010年公司竞争优势分析

四、公司国际化战略发展

第五章 2009-2010年中国挠性覆铜板产业运营态势分析

第一节 2009-2010年中国挠性覆铜板产业发概况

一、国内挠性覆铜板产品结构分析

二、中国挠性覆铜板应用情况分析

三、中国挠性覆铜板生产情况分析

第二节 2009-2010年中国挠性覆铜板市场运行现状分析

一、挠性覆铜板需求格局分析

二、中国挠性覆铜板市场发展机遇分析

三、挠性覆铜板市场最新动态分析

第三节 2009-2010年中国挠性覆铜板发展存在的问题与对策分析

第六章 2009-2010年中国挠性覆铜板相关行业发展形势分析

第一节 2009-2010年中国挠性印制电路业发展分析

一、我国FPC生产现状

二、我国FPC生产企业的现状

三、我国FPC业技术的现状

第二节 二层型挠性覆铜板在LCD的IC驱动用COF市场现状与发展

一、驱动IC用COF

二、驱动IC用COF挠性基板的性能特点及市场发展

三、我国COF挠性基板生产现状

第七章 2006-2010年中国挠性覆铜板相关行业主要数据监测分析

第一节 2006-2010年5月中国印制电路板制造行业规模分析

一、企业数量增长分析

二、从业人数增长分析

三、资产规模增长分析

第二节 2010年5月中国印制电路板制造行业结构分析

一、企业数量结构分析

1、不同类型分析

2、不同所有制分析

二、销售收入结构分析

1、不同类型分析

2、不同所有制分析

第三节 2006-2010年5月中国印制电路板制造行业产值分析

一、产成品增长分析

二、工业销售产值分析

三、出口交货值分析

第四节 2006-2010年5月中国印制电路板制造行业成本费用分析

一、销售成本分析

二、费用分析

第五节 2006-2010年5月中国印制电路板制造行业盈利能力分析

一、主要盈利指标分析

二、主要盈利能力指标分析

第八章 2006-2009年中国覆铜板及铜箔（74101100）进出口数据监测分析

第一节 2006-2009年中国覆铜板及铜箔进口数据分析

一、进口数量分析

二、进口金额分析

第二节 2006-2009年中国覆铜板及铜箔出口数据分析

一、出口数量分析

二、出口金额分析

第三节 2006-2009年中国覆铜板及铜箔进出口平均单价分析

第四节 2006-2009年中国覆铜板及铜箔进出口国家及地区分析

一、进口国家及地区分析

二、出口国家及地区分析

第九章 2009-2010年中国覆铜板重点企业竞争力与关键性财务分析

第一节 依顿(广东)电子科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 山东金宝电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节 金安国纪科技股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第四节 陕西生益科技有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第五节 无锡宏仁电子材料科技有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第六节 江门建滔积层板有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第七节 苏州松下电工有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第八节 依顿(中山)多层线路板有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第九节 国际层压板材有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十章 2009-2010年中国印刷电路板行业市场运行现状分析

第一节 2009-2010年中国印刷电路板行业的总体概况

一、中国印刷电路板行业增长速度远高于行业平均速度

二、我国将成为世界最大产业基地

三、台湾柔性PCB公司在华东形成产业集群

四、低端PCB（4层以下）竞争比较充分，集中度较低

五、高端PCB（HDI等）处于供不应求的状态

第二节 2009-2010年我国印刷电路板市场发展现状分析

一、印刷电路板市场生产结构分析

二、印刷电路板市场需求特点分析

三、印刷电路板市场技术发展分析

第三节 2009-2010年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析

一、产品集中于中低端成本转嫁能力弱

二、应对专利和新环保政策

三、内地本土所贡献的产出值比例很小

第四节 2009-2010年中国印刷电路行业发展对策分析

第十一章 2010-2015年中国挠性覆铜板行业发展前景预测分析

第一节 2010-2015年中国挠性覆铜板行业发展趋势分析

- 一、2010-2015年中国挠性覆铜板行业发展走向分析
- 二、对未来FPC技术发展的预测
- 三、FPC发展对FCCL提出更高性能的要求

第二节 2010-2015年中国挠性覆铜板行业市场预测分析

- 一、挠性覆铜板供给预测
- 二、挠性覆铜板市场需求预测
- 三、挠性覆铜板产品价格走势预测

第三节 2010-2015年中国挠性覆铜板行业盈利能力预测

第十二章 2009-2010年中国挠性覆铜板用主要原材料业运行动态分析

第一节 挠性覆铜板用绝缘基膜--PI薄膜

- 一、绝缘基膜的生产方式
- 二、FCCL发展对绝缘基膜性能提出了更高的要求
- 三、世界FCCL用PI薄膜在品种和性能上的发展

第二节 挠性覆铜板用导电材料

- 一、各类铜箔的品种及特征
- 二、压延铜箔
- 三、电解铜箔
- 四、FCCL发展对铜箔性能提出更高的要求

第三节 挠性覆铜板用胶粘剂

- 一、FPC用胶粘剂发展概述
- 二、丙烯酸酯粘合剂研究与应用的状况
- 三、环氧树脂粘合剂研究与应用的状况
- 四、聚酰亚胺粘合剂研究与应用的状况
- 五、世界FPC及FCCL用胶粘剂的主要生产厂家及品种

第四节 挠性覆铜板用覆盖膜

第十三章 2010-2015年中国挠性覆铜板行业投资机会与风险分析

第一节 2010-2015年中国挠性覆铜板行业投资环境分析

第二节 2010-2015年挠性覆铜板行业投资机会分析

一、规模的发展及投资需求分析

二、总体经济效益判断

三、与产业政策调整相关的投资机会分析

第三节 2010-2015年中国挠性覆铜板行业投资风险分析

一、市场竞争风险

二、原材料压力风险分析

三、技术风险分析

四、政策和体制风险

五、外资进入现状及对未来市场的威胁

第四节 专家建议

图表目录：

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造行业企业数量及增长率分析 单位：个

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造行业亏损企业数量及增长率分析 单位：个

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造行业从业人数及同比增长分析 单位：个

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造企业总资产分析 单位：亿元

图表：2010年中国印制电路板制造行业不同类型企业数量 单位：个

图表：2010年中国印制电路板制造行业不同所有制企业数量 单位：个

图表：2010年中国印制电路板制造行业不同类型销售收入 单位：千元

图表：2010年中国印制电路板制造行业不同所有制销售收入 单位：千元

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造产成品及增长分析 单位：亿元

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造工业销售产值分析 单位：亿元

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造出口交货值分析 单位：亿元

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造行业销售成本分析 单位：亿元

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造行业费用分析 单位：亿元

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造行业主要盈利指标分析 单位：亿元

图表：2006-2010年5月中国印制电路板制造行业主要盈利能力指标分析

图表：2006-2009年中国覆铜板及铜箔进口数量分析

图表：2006-2009年中国覆铜板及铜箔进口金额分析

图表：2006-2009年中国覆铜板及铜箔出口数量分析

图表：2006-2009年中国覆铜板及铜箔出口金额分析

图表：2006-2009年中国覆铜板及铜箔进出口平均单价分析

图表：2006-2009年中国覆铜板及铜箔进口国家及地区分析

图表：2006-2009年中国覆铜板及铜箔出口国家及地区分析

图表：依顿(广东)电子科技有限公司主要经济指标走势图

图表：依顿(广东)电子科技有限公司经营收入走势图

图表：依顿(广东)电子科技有限公司盈利指标走势图

图表：依顿(广东)电子科技有限公司负债情况图

图表：依顿(广东)电子科技有限公司负债指标走势图

图表：依顿(广东)电子科技有限公司运营能力指标走势图

图表：依顿(广东)电子科技有限公司成长能力指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司主要经济指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司经营收入走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司盈利指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司负债情况图

图表：山东金宝电子股份有限公司负债指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司运营能力指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司成长能力指标走势图

图表：金安国纪科技股份有限公司主要经济指标走势图

图表：金安国纪科技股份有限公司经营收入走势图

图表：金安国纪科技股份有限公司盈利指标走势图

图表：金安国纪科技股份有限公司负债情况图

图表：金安国纪科技股份有限公司负债指标走势图

图表：金安国纪科技股份有限公司运营能力指标走势图

图表：金安国纪科技股份有限公司成长能力指标走势图

图表：陕西生益科技有限公司主要经济指标走势图

图表：陕西生益科技有限公司经营收入走势图

图表：陕西生益科技有限公司盈利指标走势图

图表：陕西生益科技有限公司负债情况图

图表：陕西生益科技有限公司负债指标走势图

图表：陕西生益科技有限公司运营能力指标走势图

图表：陕西生益科技有限公司成长能力指标走势图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司主要经济指标走势图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司经营收入走势图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司盈利指标走势图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司负债情况图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司负债指标走势图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司运营能力指标走势图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司成长能力指标走势图

图表：江门建滔积层板有限公司主要经济指标走势图

图表：江门建滔积层板有限公司经营收入走势图

图表：江门建滔积层板有限公司盈利指标走势图

图表：江门建滔积层板有限公司负债情况图

图表：江门建滔积层板有限公司负债指标走势图

图表：江门建滔积层板有限公司运营能力指标走势图

图表：江门建滔积层板有限公司成长能力指标走势图

图表：苏州松下电工有限公司主要经济指标走势图

图表：苏州松下电工有限公司经营收入走势图

图表：苏州松下电工有限公司盈利指标走势图

图表：苏州松下电工有限公司负债情况图

图表：苏州松下电工有限公司负债指标走势图

图表：苏州松下电工有限公司运营能力指标走势图

图表：苏州松下电工有限公司成长能力指标走势图

图表：依顿(中山)多层线路板有限公司主要经济指标走势图

图表：依顿(中山)多层线路板有限公司经营收入走势图

图表：依顿(中山)多层线路板有限公司盈利指标走势图

图表：依顿(中山)多层线路板有限公司负债情况图

图表：依顿(中山)多层线路板有限公司负债指标走势图

图表：依顿(中山)多层线路板有限公司运营能力指标走势图

图表：依顿(中山)多层线路板有限公司成长能力指标走势图

图表：国际层压板材有限公司主要经济指标走势图

图表：国际层压板材有限公司经营收入走势图

图表：国际层压板材有限公司盈利指标走势图

图表：国际层压板材有限公司负债情况图

图表：国际层压板材有限公司负债指标走势图

图表：国际层压板材有限公司运营能力指标走势图

图表：国际层压板材有限公司成长能力指标走势图

博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国挠性覆铜板（FCCL）行业市场分析与投资前景研究报告》，内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1101/Q77504338O.html>